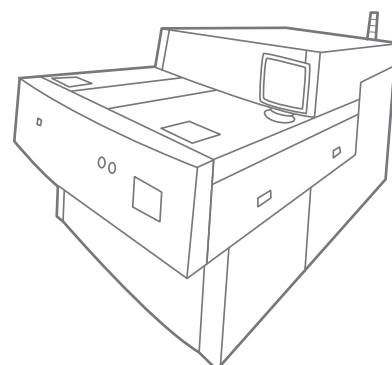


Paragon™-Ultra 系列

IC 载板激光直接成像

PCB 生产解决方案



Paragon™-Ultra 系列



Paragon™-Ultra 激光直接成像 (LDI) 系统采用奥宝科技最先进的大镜面扫描技术 (Large Scan Optics Technology™)，为当今最复杂的IC载板应用提供最高的成像精度和产能，包括 Flip-Chip BGA、Flip-Chip CSP、BGA/CSP和模块制造。

优势

IC 载板制造的最高成像质量

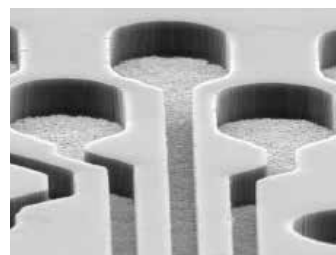
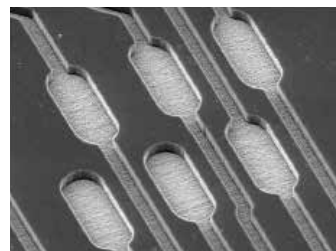
- 采用大镜面扫描技术 (Large Scan Optics Technology™)，实现高均匀度精细成像
- 最小特征尺寸低至8 μ m，最小跨距为20 μ m
- 针对复杂应用的创新涨缩模式
- 对位精准度可达 $\pm 5\mu$ m
- 支持SAP、MSAP及减成工艺

简单易用

- 直观、友好的用户界面，易于快速设置
- 可识别一系列不同类型的靶点
- 带有一体式 UV Marker 的无孔内层对位技术
- 无论使用传统干膜还是 LDI 感光膜均可实现出现的结果

自动化操作

- 减少人工操作，提高效率
- 灵活配置 - 单机，在线或机器人系统
- 无缝的自动化连接
- 洁净，无需人工操作的环境



细线特征：最小特征尺寸 $\geq 8\mu$ m
最小跨距 $\geq 20\mu$ m



IC 载板制造的最高成像质量

Paragon™-Ultra 专门从事集成电路基板的设计生产，在半加成、半加成改良型和减成等各种工艺方面均具有深厚经验。利用奥宝科技的大镜面扫描技术 (Large Scan Optics Technology™) 的先进能力，可确保在精细的分辨率下实现最高水平的成像品质。创新的涨缩模式能够灵活适应各种复杂的应用，最小特征尺寸可达 $8\mu\text{m}$ ，最小跨距可达 $20\mu\text{m}$ 。该系统实现了 $\pm 5\mu\text{m}$ 的对位精度和精确孔环。

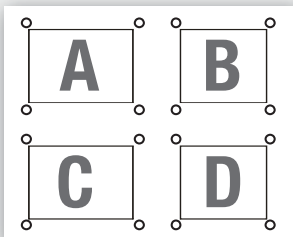
对位精度

- 层间对位精度可达 $10\mu\text{m}$
- 实现孔环（高至 $\pm 5\mu\text{m}$ ，FTG）和较小焊盘的成像

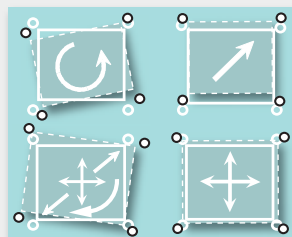
创新的涨缩模式

- 每块板子可根据其变形使用以下方法进行涨缩：自动涨缩、固定涨缩、群组涨缩或固定测量涨缩
- 对于严重变形的板子：分割涨缩，以进行有效、准确的分割对位

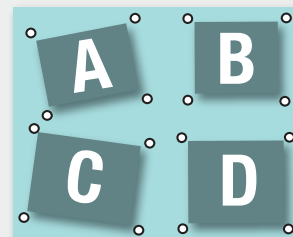
Data



Panel



Imaging



分割涨缩一次曝光实现精准的分区分位能力。

简单易用

Paragon™-Ultra 具有用户友好的界面，操作非常快速方便。直接使用 CAM 数据，进行简单及步骤清晰的曝光。系统会自动识别出多种不同类型的靶点。还可以使用 UV Marker 达成无孔内层对位功能。只要按下一个按钮，Paragon™-Ultra 即可按照用户定义的参数以最高产能对每片板子进行成像。无论使用传统干膜还是 LDI 感光膜均可实现出色的结果。

自动化操作

Paragon™-Ultra 系统可通过在线和单机自动化配置满足您的生产需求。Paragon™-Ultra 在一个洁净、无需人工操作的环境下工作，以尽可能减少人工操作的损害，提高效率。它还采用了特别设计，重量更轻，占地面积小，从而节省运营成本。